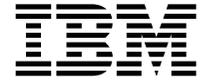


IBM Power System S822LC for Big Data (8001-22C)クイック インストール・ガイド



IBM Power® System S822LC for Big Data (8001-22C) クイック インストール・ガイド

IBM Knowledge Center は、http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8hdx/8001_22c_landing.htm からオンラインで使用できます。

- 主要な部品に対する作業を開始する前に、予防措置と手順に関するすべての説明をお読みください。
- システムおよび部品に対して作業を行うときは、静電気の放電 (ESD) の正しい手順を使用してください。IBM は、機器に損傷を与えるおそれがないよう、手袋と帯電防止リスト・ストラップを装着することをお勧めしています。

8001-22C 情報: <https://ibm.biz/8001-22CQR>

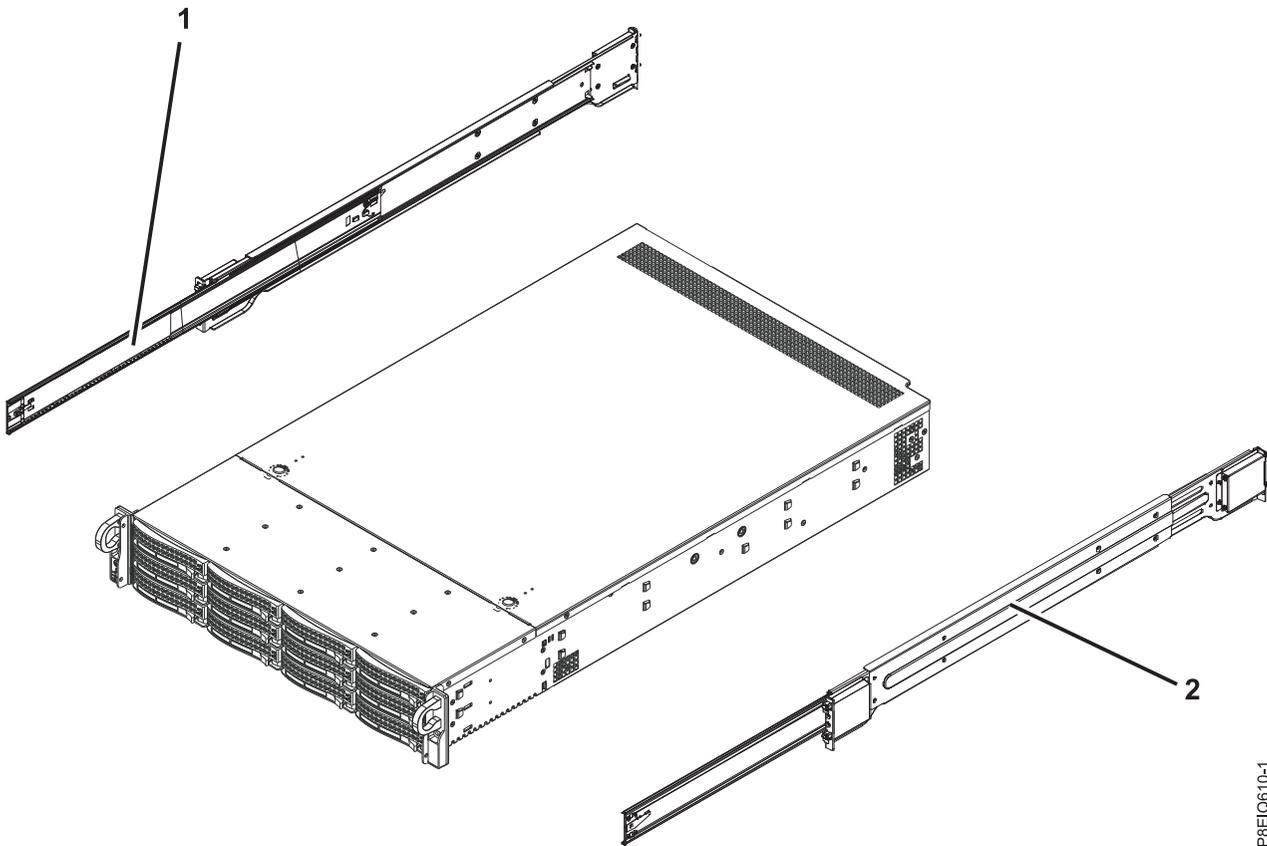


8001-22C の部品

現場交換可能ユニット (FRU) の部品番号を見つけるには、次の情報を使用します。

発注する部品の部品番号を特定したら、Advanced Part Exchange Warranty Service にアクセスしてください。登録が必要です。部品番号を特定できない場合には、Contacting IBM® service and support にアクセスしてください。

ラック最終アセンブリー



P8E1C610-1

図 1. ラック最終アセンブリー

表 1. ラック最終アセンブリーの部品番号

索引番号	部品番号	アセンブリー当たりのユニット数	説明
1	MCP-290-00057-0N	1	スライド・レール・キット - 左右のスライド・レールと取り付けねじを含んでいます。
2	MCP-290-00057-0N	1	スライド・レール・キット - 左右のスライド・レールと取り付けねじを含んでいます。

システム部品

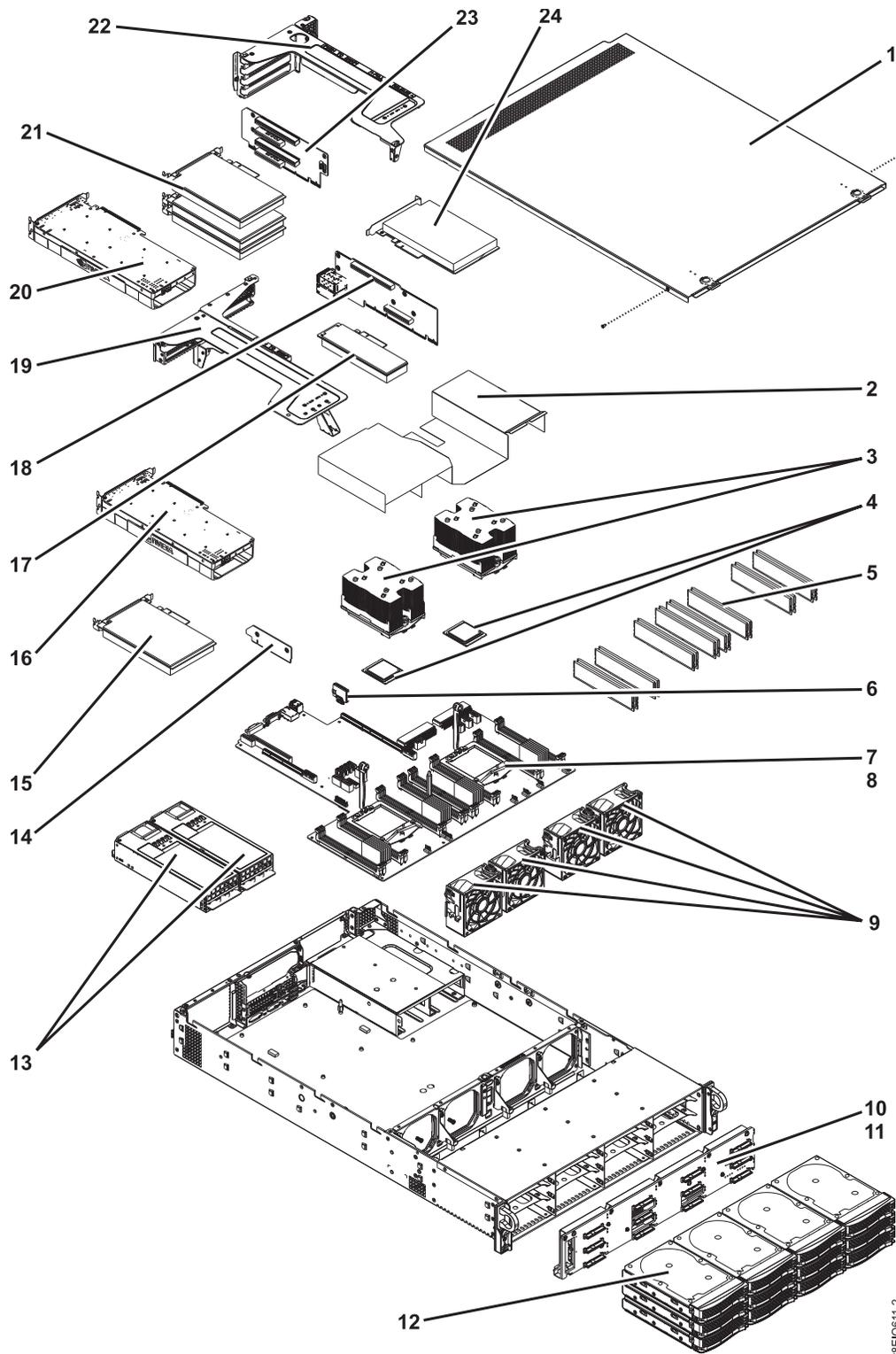


図 2. システム部品

P8E1C0611-2

表 2. システム部品

索引番号	部品番号	アセンブリー当たりのユニット数	説明
1		1	トップ・カバー・アセンブリー
		2	ねじ
2	MCP-310-82914-0B	1	CPU エア・バッフル
3	SNK-P0053P-IB001	2	ヒート・シンク・キット (ヒート・シンクおよび熱伝導材料が含まれています)
4	00UL866	2	8 コア 3.325 GHz システム・プロセッサ・モジュール
	00UL864	2	10 コア 2.926 GHz システム・プロセッサ・モジュール
	00UL010	2	11 コア 2.893 GHz システム・プロセッサ・モジュール
5	MTA9ASF51272PZ-2G3B1	16	4 GB、2400 MHz 1RX8 DDR4 RDIMM (Micron Technology, Inc.)*
	MTA9ASF1G72PZ-2G3B1	16	8 GB、2400 MHz 1RX8 DDR4 RDIMM (Micron Technology, Inc.)*
	MTA18ASF2G72PZ-2G3B1	16	16 GB、2400 MHz 1RX4 DDR4 RDIMM (Micron Technology, Inc.)*
	MTA36ASF4G72PZ-2G3A1	16	32 GB、2400 MHz 2RX4 DDR4 RDIMM (Micron Technology, Inc.)*
	M393A1G40DB0-CPB	16	8 GB、2133 MHz 1RX4 DDR4 RDIMM (Samsung Electronics Co., Ltd.)*
	M393A2G40DB0-CPB	16	16 GB、2133 MHz 2RX4 DDR4 RDIMM (Samsung Electronics Co., Ltd.)*
	M393A4K40BB0-CPB	16	32 GB、2133 MHz 2RX4 DDR4 RDIMM (Samsung Electronics Co., Ltd.)*
	HMA41GR7AFR4N-TF	16	8 GB、2133 MHz 1RX4 DDR4 RDIMM (SK hynix, Inc.)*
	HMA42GR7AFR4N-TF	16	16 GB、2133 MHz 2RX4 DDR4 RDIMM (SK hynix, Inc.)*
HMA84GR7MFR4N-TFT1	16	32 GB、2133 MHz 2RX4 DDR4 RDIMM (SK hynix, Inc.)*	
6	SSD-DM064-PHI	2	64 GB SATA ドライブ・オン・モジュール (DOM)
	SSD-DM128-SMCMVN1	2	128 GB SATA ドライブ・オン・モジュール (DOM)
7	MBD-P8DTU	1	システム・バックプレーン
8		10	ねじ
9	FAN-0166L4	4	ファン
10	BPN-SAS3-826A	1	ディスク・ドライブ・バックプレーン (12 個の SAS または SATA ドライブをサポート)
	BPN-SAS3-826EL1-N4	1	ディスク・ドライブ・バックプレーン (8 個の SAS または SATA ドライブ、および 4 個の SAS、SATA、または NVMe ドライブをサポート)
11		7	ねじ
12	HDD-A2000-ST2000NM003401	12	2 TB 3.5 型 SAS ディスク・ドライブ
12	HDD-A4000-ST4000NM003401 または HDD-A4TB- HUS726040AL5210	12	4 TB 3.5 型 SAS ディスク・ドライブ
12	HDD-A6000-ST6000NM003401	12	6 TB 3.5 型 SAS ディスク・ドライブ
12	HDD-A8000-ST8000NM0075	12	8 TB 3.5 型 SAS ディスク・ドライブ
12	HDD-A4000-ST4000NM0075	12	4 TB 3.5 型自己暗号化 SAS ディスク・ドライブ
12	HDD-A8000-ST8000NM0095	12	8 TB 3.5 型自己暗号化 SAS ディスク・ドライブ
12	HDD-T2000-ST2000NM002401	12	2 TB 3.5 型 SATA ディスク・ドライブ
12	HDD-T4000-ST4000NM002401	12	4 TB 3.5 型 SATA ディスク・ドライブ
12	HDD-T6000-ST6000NM002401	12	6 TB 3.5 型 SATA ディスク・ドライブ
12	HDD-T8000-ST8000NM0055	12	8 TB 3.5 型 SATA ディスク・ドライブ
12	HDS-KIT-2A-1920-IB001	12	1.9 TB Small-Form Factor SAS ソリッド・ステート・ドライブ (1 日あたりのドライブ書き込み 1 回)
12	HDS-KIT-2A-3840-IB001	12	3.8 TB Small-Form Factor SAS ソリッド・ステート・ドライブ (1 日あたりのドライブ書き込み 1 回)
12	HDS-KIT-2T-160-IB001	12	160 GB 2.5 インチ、スモール・フォーム・ファクター SATA ソリッド・ステート・ドライブ
12	HDS-KIT-2T-240-IB001	12	240 GB 2.5 インチ、スモール・フォーム・ファクター SATA ソリッド・ステート・ドライブ
12	HDS-KIT-2T-960-IB001	12	960 GB 2.5 インチ、スモール・フォーム・ファクター SATA ソリッド・ステート・ドライブ
12	HDS-KIT-2T-1900-IB001	12	1.9 TB 2.5 インチ、スモール・フォーム・ファクター SATA ソリッド・ステート・ドライブ
12	HDS-KIT-2T-3800-IB001	12	3.8 TB 2.5 インチ、スモール・フォーム・ファクター SATA ソリッド・ステート・ドライブ
12	HDS-KIT-3N-800-IB001	4	800 GB 2.5 インチ、スモール・フォーム・ファクター NVMe ドライブ (1 日当たり 3 ドライブ書き込み)
12	HDS-KIT-3N-1200-IB001	4	1.2 TB 2.5 インチ、スモール・フォーム・ファクター NVMe ドライブ (1 日当たり 3 ドライブ書き込み)
12	HDS-KIT-3N-1600-IB001	4	1.6 TB 2.5 インチ、スモール・フォーム・ファクター NVMe ドライブ (1 日当たり 3 ドライブ書き込み)
12	HDS-KIT-3N-2000-IB001	4	2.0 TB 2.5 インチ、スモール・フォーム・ファクター NVMe ドライブ (1 日当たり 3 ドライブ書き込み)

表 2. システム部品 (続き)

索引番号	部品番号	アセンブリ当たりのユニット数	説明
12	HDS-KIT-5N-800-IB001	4	800 GB 2.5 インチ、スモール・フォーム・ファクター NVMe ドライブ (1 日当たり 5 ドライブ書き込み)
12	HDS-KIT-5N-3200-IB001	4	3.2 TB 2.5 インチ、スモール・フォーム・ファクター NVMe ドライブ (1 日当たり 5 ドライブ書き込み)
13	PWS-1K62A-1R	2	電源装置
14	RSC-R1UW-E8R	1	PCIe アダプター 3 用の PCIe ライザー (PLX スロット 1)
15		1	PCI アダプター。アダプターのフィーチャー・タイプを使用して、8001-22C のフィーチャー・タイプ別の PCIe アダプター情報で FRU 番号を見つけてください
16		1	GPU。GPU のフィーチャー・タイプを使用して、8001-22C のフィーチャー・タイプ別の PCIe アダプター情報で FRU 番号を検索してください。
17		1	PCI アダプター。アダプターのフィーチャー・タイプを使用して、8001-22C のフィーチャー・タイプ別の PCIe アダプター情報で FRU 番号を見つけてください。
18	AOC-2UR66-i4XTF	1	2U UIO NIC PCIe アダプター (統合 4 ポート 10 GbE Base-T、Intel XL710、および CAPI 搭載) 注: この PCIe アダプターは、PCIe ライザーとしても機能します。
19		1	PCIe ケージ
20		1	GPU。GPU のフィーチャー・タイプを使用して、8001-22C のフィーチャー・タイプ別の PCIe アダプター情報で FRU 番号を検索してください。
21		3	PCIe アダプター。アダプターのフィーチャー・タイプを使用して、8001-22C のフィーチャー・タイプ別の PCIe アダプター情報で FRU 番号を見つけてください。
22		1	PCIe ライザー
23	RSC-W2-688P	1	PCIe ライザー PCIe アダプター 4 または GPU 2 (WIO スロット 1)、PCIe アダプター 5 (WIO スロット 2)、および PCIe アダプター 6 (WIO スロット 3)
24		1	PCI アダプター。アダプターのフィーチャー・タイプを使用して、8001-22C のフィーチャー・タイプ別の PCIe アダプター情報で FRU 番号を見つけてください

*8001-22C システム内のメモリーはすべて、同じサイズのもので、同じ製造業者のものでなければなりません。8001-22C システムでは、異なるサイズのメモリーの混合および異なる供給業者からのメモリーの混合はサポートされません。

背面ポート

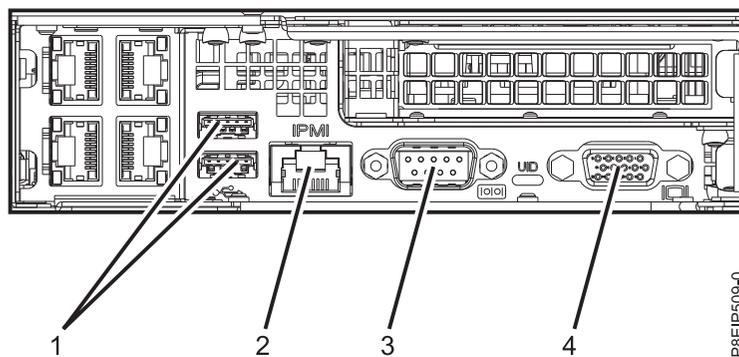


図 3. 背面ポート

表 3. 入出力ポート

ID	説明
1	USB 2.0 (キーボードとマウスに使用)
2	Ethernet Intelligent Platform Management Interface (IPMI)
3	Serial IPMI

表 3. 入出力ポート (続き)

ID	説明
4	Video Graphics Array (VGA) (モニターに使用)。1024 x 768、60 Hz VGA 設定のみがサポートされます。最大 3 メートルのケーブルのみがサポートされます。現時点でサポートされているのは、テキスト・ベース機能のみです。

取り付けと取り外し

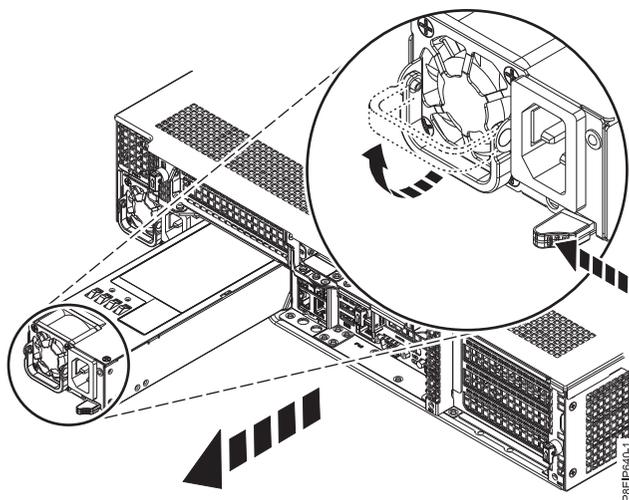


図 4. システムから電源装置を取り外す

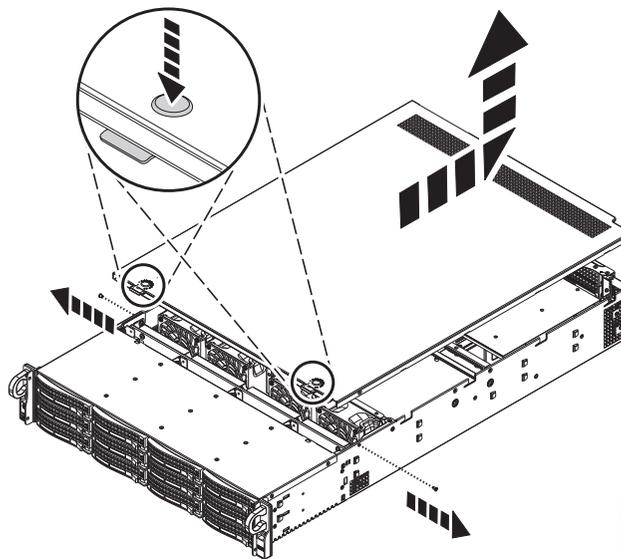


図 5. カバーを解放して開く

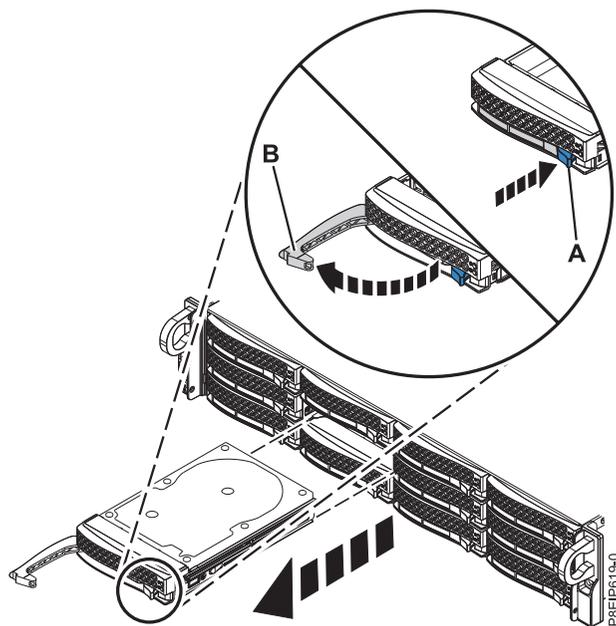


図 6. ドライブの取り外し

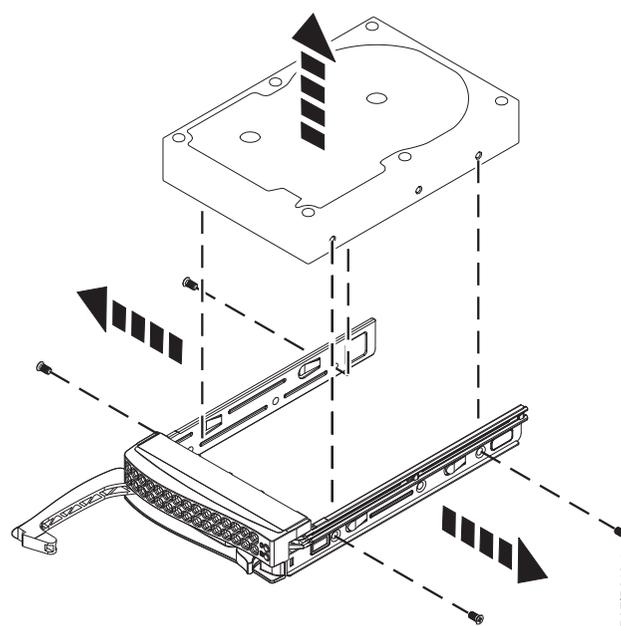


図 7. トレイからの 3.5 型ドライブの取り外し

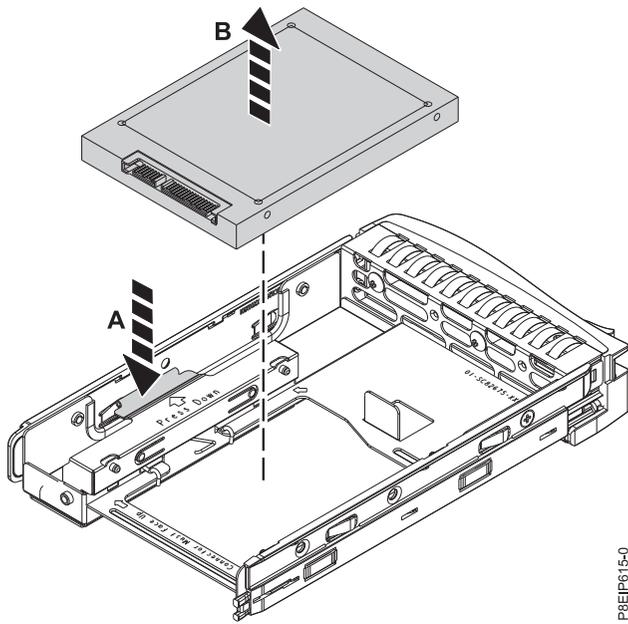


図 8. トレイからの 2.5 型ドライブの取り外し

P8EIP615-0

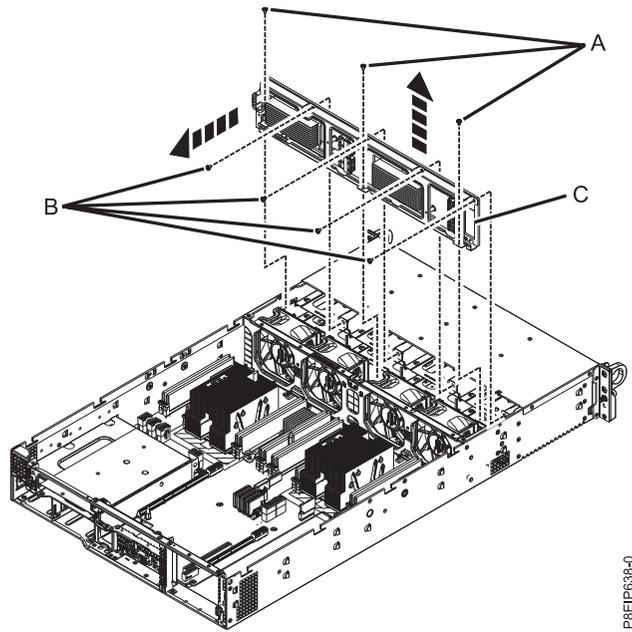


図 9. ディスク・ドライブ・バックプレーンとねじの取り外し

P8EIP635-0

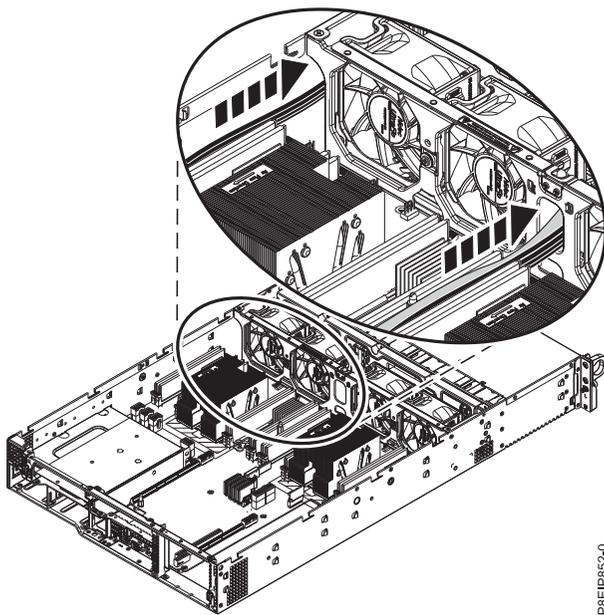


図 10. ディスク・ドライブ・バックプレーンのケーブルの取り外し

P8EIP852-0

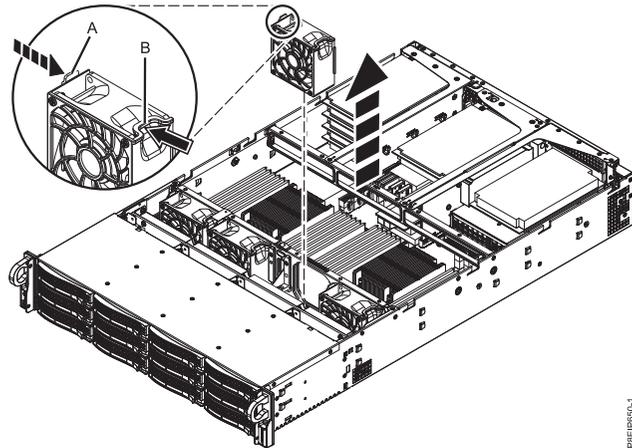


図 11. ファンの取り外し

P8EIP950-1

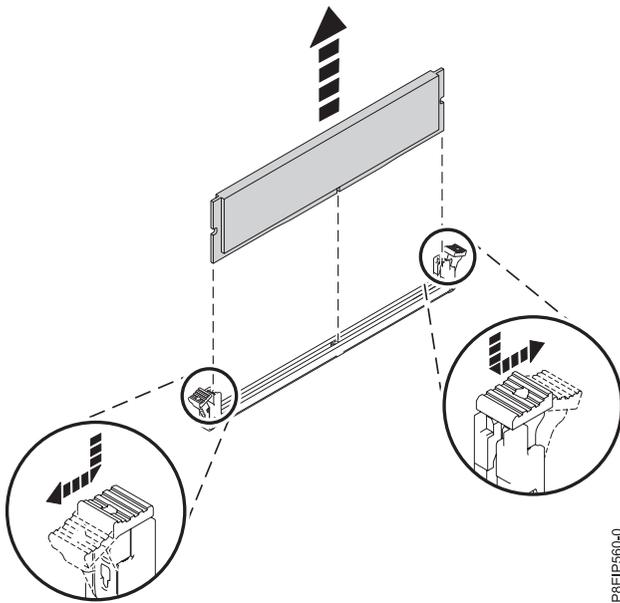


図 12. メモリーの取り外し

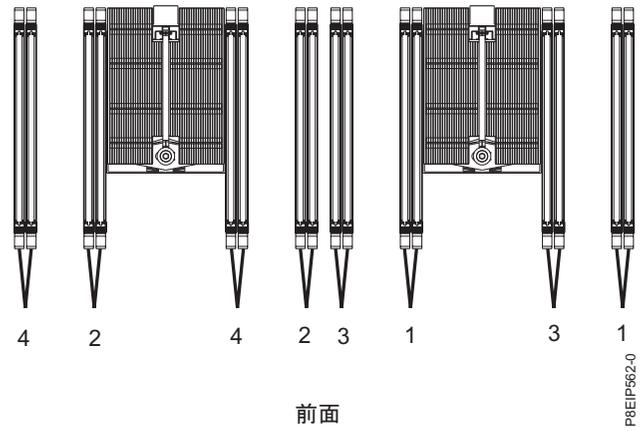


図 13. メモリー・スロット位置と差し込み順序

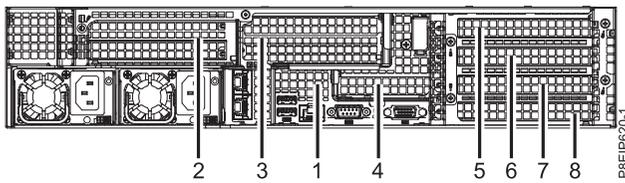


図 14. 8001-22C PCIe アダプターの位置

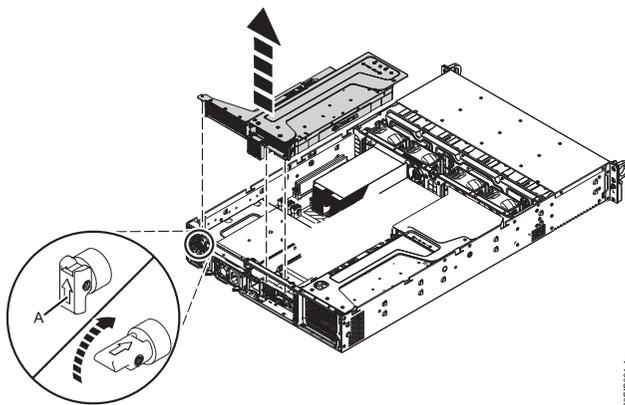


図 15. PCIe ライザーの取り外し

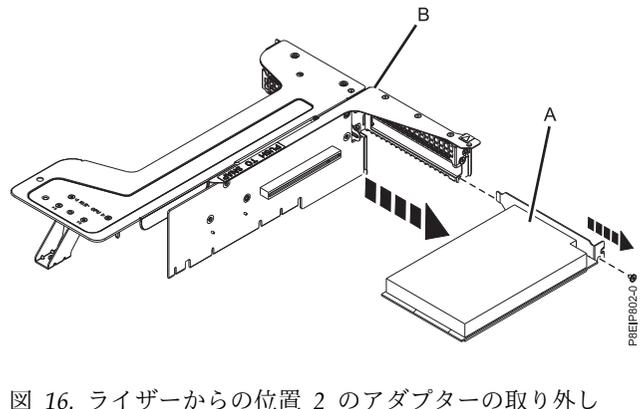


図 16. ライザーからの位置 2 のアダプターの取り外し

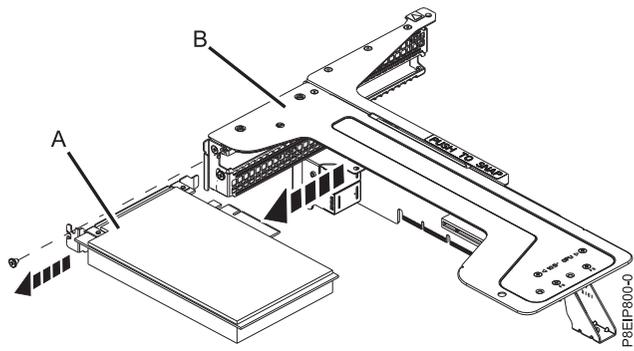


図 17. ライザーからの位置 3 のアダプターの取り外し

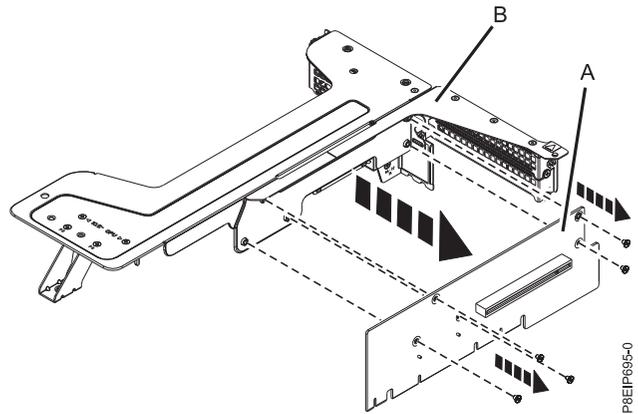


図 18. 位置 1 のライザー・カードの取り外し

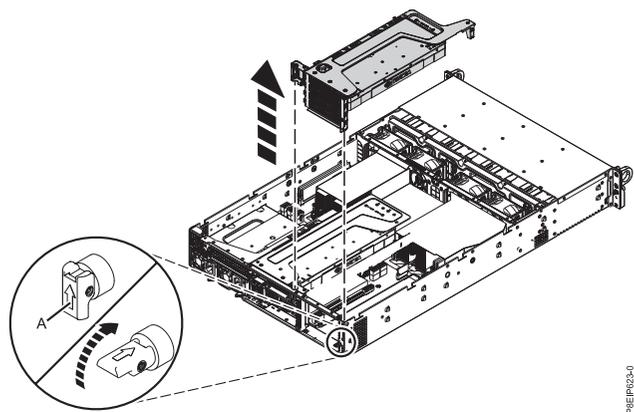


図 19. PCIe ライザーの取り外し

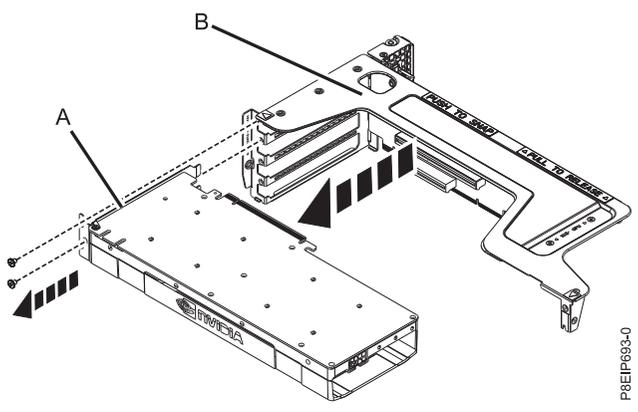


図 20. ライザーからの GPU の取り外し

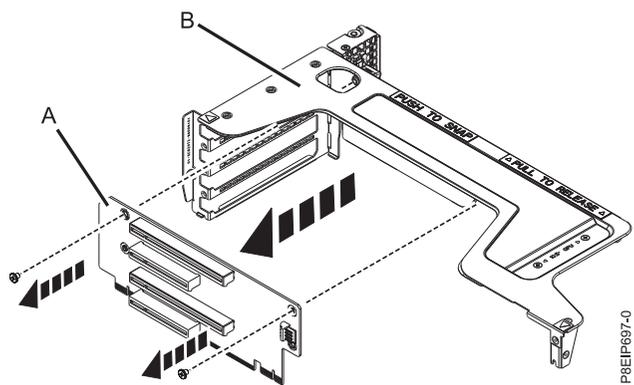


図 21. 位置 5、6、7、および 8 のライザー・カードの取り外し

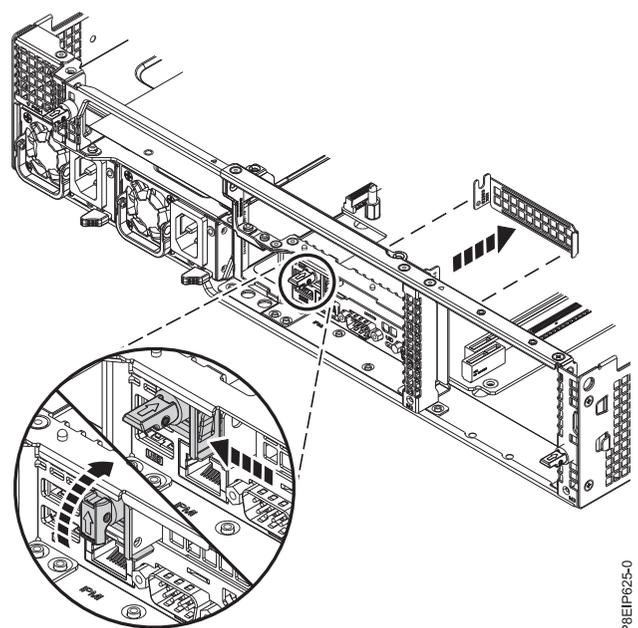


図 22. テール・ストックのリリース

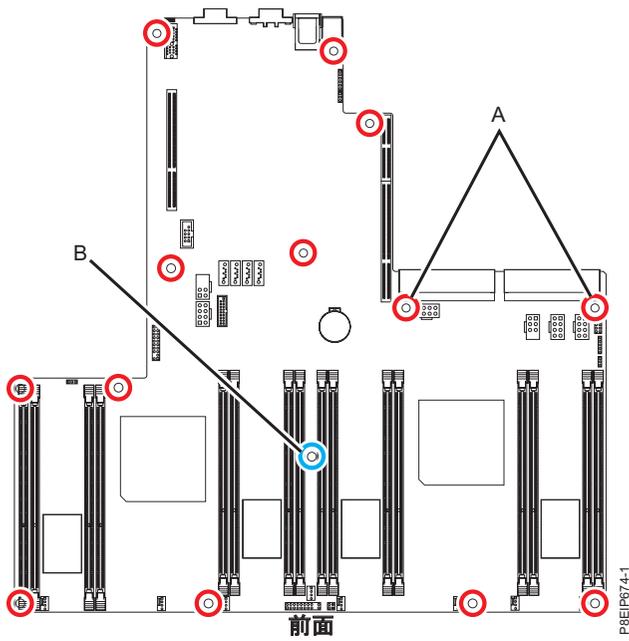


図 23. ねじの位置

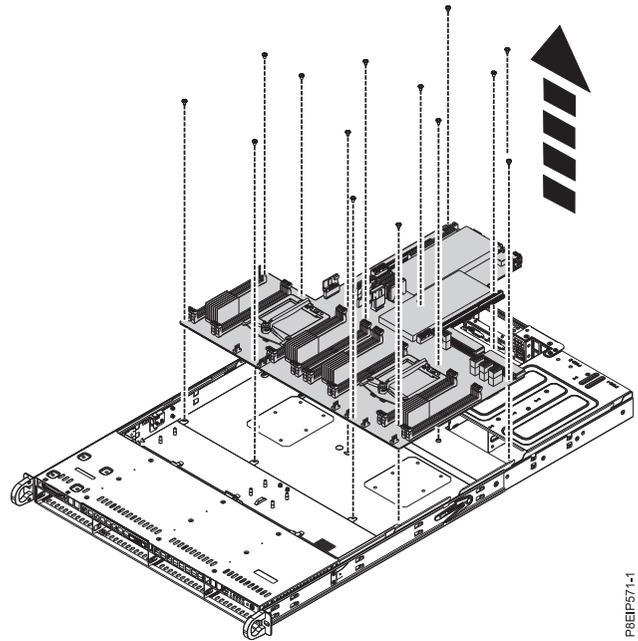


図 24. システム・バックプレーンを持ち上げて外す

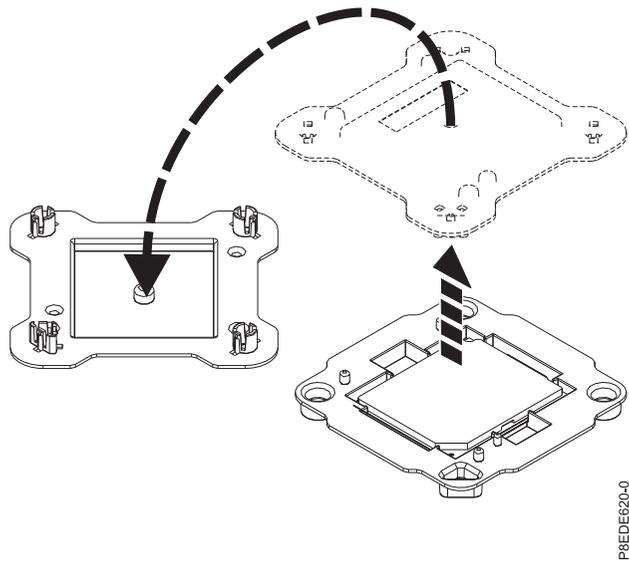


図 25. システム・プロセッサ・モジュールのパッケージを開く

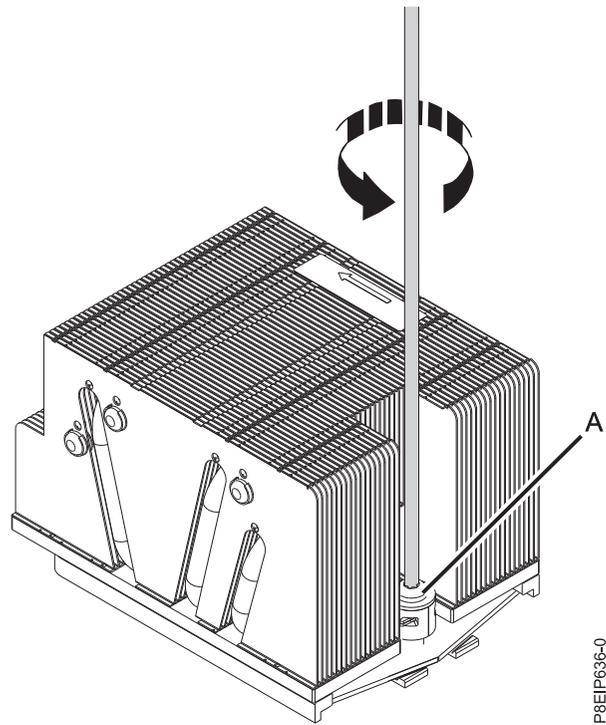


図 26. ヒート・シンクのロード・アームねじを緩める

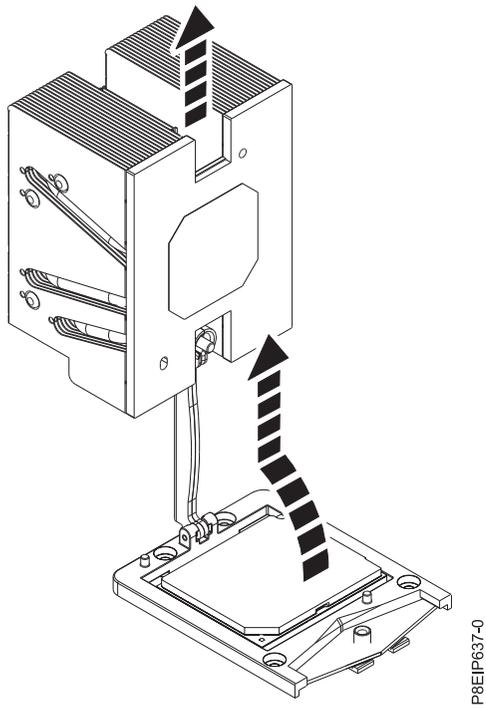


図 27. ロード・アームからヒート・シンクを持ち上げる

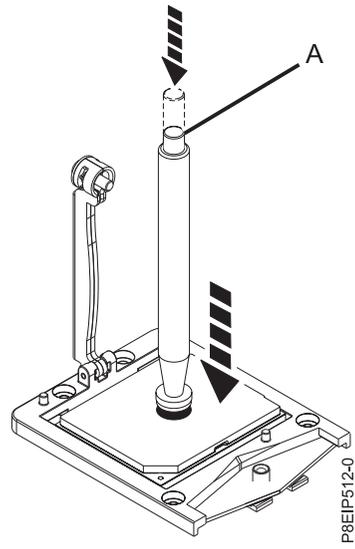


図 28. システム・プロセッサ・モジュールへの真空ペンのロック

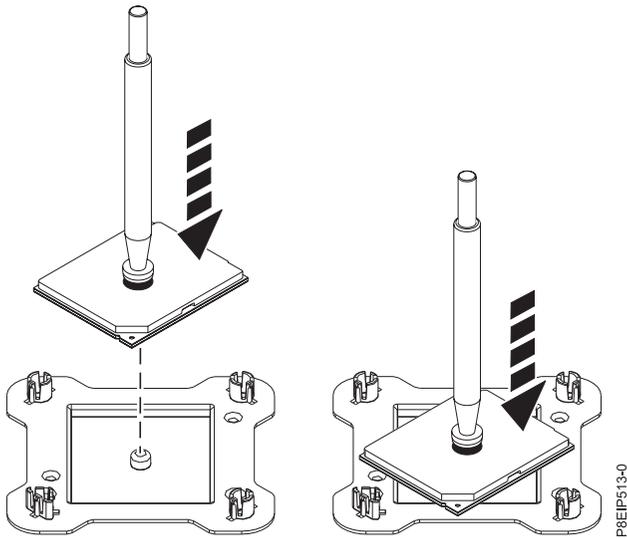


図 29. パッケージのトップ・カバーにプロセッサを斜めに置く

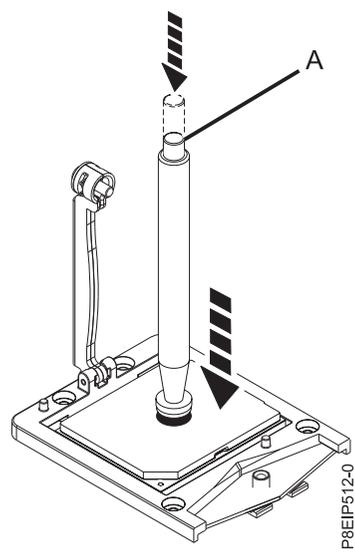


図 30. 取り外しツールをシステム・プロセッサ・モジュールの上を下ろす

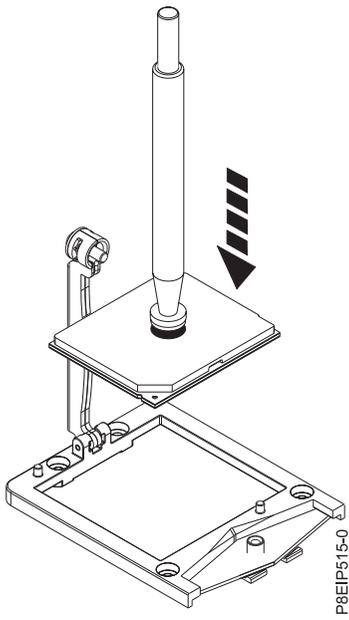


図 31. プロセッサをソケットに下ろす

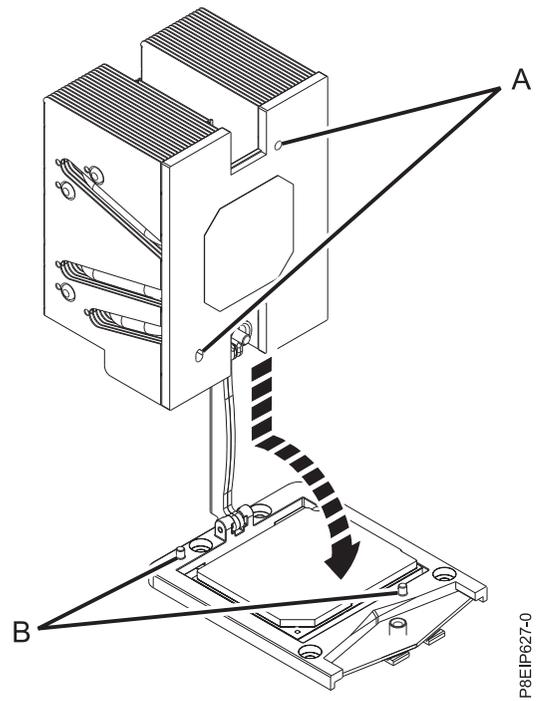


図 32. ヒート・シンクの取り付け

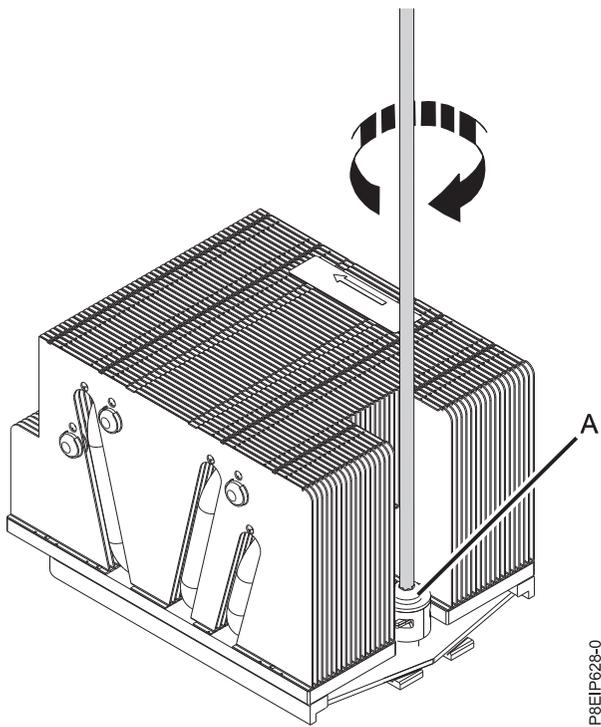
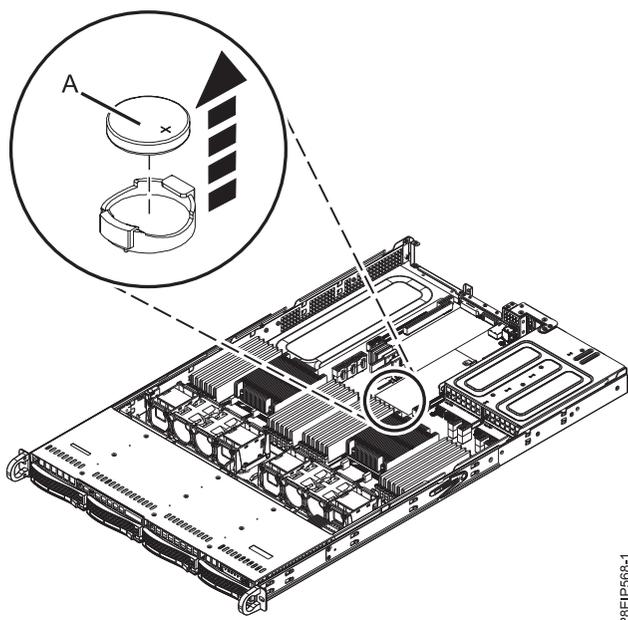


図 33. ロード・アームのねじを締める



P0EIP568-1

図 34. 時刻バッテリーの位置

本書は、POWER8 プロセッサを搭載した IBM Power Systems サーバーおよびすべての関連モデルに適用されま
す。

本装置は、高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 に適合しています。

本製品およびオプションに電源コード・セットが付属する場合は、それぞれ専用のものになっていますので他の電気機
器には使用しないでください。本体機器提供後に、追加で電源コード・セットが必要となった場合は、補修用の取扱い
となります。

© Copyright IBM Corporation 2015, 2017.